

Lagenaufbau

Ebene	Komponente	Dicke (mm)	Cu (my)	Typ
1	Cu+galv.Cu		70+25	
	Prepreg	0.183		7628
	Prepreg	0.183		7628
2	Cu	0.20	105	
	Tr-Lam		105	
3	Cu			
	Prepreg	0.183		7628
	Prepreg	0.183		7628
4	Prepreg	0.183		7628
	Cu	0.20	105	
	Tr-Lam		105	
5	Cu			
	Prepreg	0.183		7628
	Prepreg	0.183		7628
6	Prepreg	0.183		7628
	Cu	0.20	105	
	Tr-Lam		105	
7	Cu			
	Prepreg	0.183		7628
	Prepreg	0.183		7628
8	Cu+galv.Cu		70+25	

Presslingsdicke*	2,89	+/- 10%
Gesamtdicke inkl. galv. Cu u. Lötstopmmaske*	3,00	+/- 10%

Bemerkungen zum Lagenaufbau:

- * Dickenberechnung mit Basismaterial FR-4 gefüllt bei 50% Kupferbelegung auf Innenlagen (abhängig von Basismaterialtyp, gewählter Kupferdicke und Kupferbelegung abweichende resultierende Isolations- und Enddicken)

- Dickentoleranz Basismaterial +/-10%
- minimale Kupferenddicken gemäß IPC 6012 aktuelle Ausgabe

Designrules zum Lagenaufbau

Durchgangslöcher [A] (Vias)	End-Ø	≥ 500 µm
	Viapad-Ø	≥ 950 µm
Leiterbild Außenlagen	Leiterbreite bei 50 µm Grundkupfer	≥ 160 µm
	Leiterabstand bei 50 µm Grundkupfer	≥ 215 µm
Standard	Leiterbreite bei 70 µm Grundkupfer	≥ 200 µm
	Leiterabstand bei 70 µm Grundkupfer	≥ 260 µm
	Leiterbreite bei 105 µm Grundkupfer	≥ 250 µm
	Leiterabstand bei 105 µm Grundkupfer	≥ 320 µm
Leiterbild Innenlagen	Leiterbreite bei 70 µm Grundkupfer	≥ 145 µm
	Leiterabstand bei 70 µm Grundkupfer	≥ 150 µm
Standard	Leiterbreite bei 105 µm Grundkupfer	≥ 175 µm
	Leiterabstand bei 105 µm Grundkupfer	≥ 190 µm